

WS 膏状助焊剂

特点

- 优异的润湿性能
- 较宽的工艺窗口
- 残留物易清洗
- 开罐后保存时间长

描述

AIM 的 WS 膏状助焊剂是一种可水洗的粘性/返工助焊剂，专为印刷电路板的局部修补或返工开发，也可用于球栅阵列（BGA）封装焊球的封装。WS 膏状助焊剂具有高活性且应用广泛，与所有锡铅和无铅合金兼容。WS 膏状助焊剂可应用于点胶、浸渍/针转印或钢网印刷。WS 膏状助焊剂有 10cc 和 30 cc 针筒包装可供选择。

应用

在进行返工操作时，助焊剂涂抹应局限于正在处理的区域。建议使用点胶针进行涂抹。

清洗

WS 膏状助焊剂必须使用普通水进行清洗。最终清洗时建议使用去离子水。保持水温温度 38°C – 60°C (100°F - 150°F) 可去除残留物。建议采用在线式或其他加压喷淋清洗系统

测试数据总结

名称	测试方法	结果
IPC 助焊剂分类	J-STD-004	ORM1
名称	测试方法	结果
铜镜	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	中
定量卤化物，铬酸银 表面绝缘电阻	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	存在卤化物
	J-STD-004 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.3	通过
酸值测定	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	酸值的典型值 50.76–56.61mg KOH/每克助焊剂
外观	J-STD-004B 3.4.2.5	深棕色
粘度		凝胶状的稠度

*All information for reference only. Not to be used as incoming product specifications or for process design. Consult Certificate of Analysis for product specific information.

DISCLAIMER The information contained herein is based on data considered accurate and is offered at no charge. Product information is based upon the assumption of proper handling and operating conditions. Liability is expressly disclaimed for any loss or injury arising out of the use of this information or the use of any materials designated. Please refer to <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> to review AIM's terms and conditions.

处理和储存

参数	时间	温度
密封保质期	6 个月	室温
密封保质期	1 年	冷藏 4-12°C

WS 助焊膏在室温下密封保存的保质期为 6 个月，冷藏保存时为 1 年。请勿将新的和使用过的助焊膏存放在同一容器中。

安全

使用时需保持充分通风并佩戴适当的个人防护装备。如有任何特定的紧急情况信息，请参阅随附的安全数据表。请勿将任何危险材料丢弃在未经批准的容器中。